



SMTA China East 华东高科技会议 Technical Conference

24th

April 2024 (Wednesday) / 2024 年 4 月 24 日(星期三)

(CE24-TC1) Technology Conference / 高科技技术研讨会

Conference Chairman/会议主席:

Wisdom Qu 瞿艳红

Member of SMTA China Technical Advisory Committee / 中国 SMTA 技术顾问委员会委员

Regional Product Manager-PCB Assembly Solder Paste of Indium Corporation

钢泰公司区域产品经理-PCB 组装焊锡膏

Venue/地点	Room No.6, B2, Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center 上海世博展览馆地下二层 6 号会议室	
Time/时间	Topic/主题	Speaker/演讲者
10:45 – 11:20	New Soldering Technology for High and Mixed Volume Through-Hole Pin Devices 用于高生产量和混合生产通孔引脚器件的新型焊接技术 (CE24-TC1.1)	Khoh Kar Heong 许教雄 ITW EAE 苏州依工电子设备有限公司
11:20 – 11:55	The Challenges and Solutions of Server Large BGA Warpage 服务器大尺寸芯片翘曲变形的解决方案 (CE24-TC1.2)	Wisdom Qu 瞿艳红 Indium Coproation 钢泰公司
11:55 – 12:30	Performance Comparison of Contemporary Stencil Coatings and Under Wipe Solvents On 0.4mm BGA Packages 当代钢网涂层和底部擦拭溶剂对 0.4mm BGA 封装的性能比较 (CE24-TC1.3)	Daniel Gao 高伟 Shanghai KYZEN Cleaning Materials Co., Ltd. 上海凯晟清洁材料有限公司
12:30– 13:45	Lunch Break / 午餐	
13:45 – 14:20	Study of Defluxing of Copper Pillar Bumped Flip Chips 去除铜柱凸块倒装芯片上焊剂的研究 (CE24-TC1.4)	Kevin Lee 李肖晨 ZESTRON North Asia ZESTRON 北亚分公司
14:20 - 14:55	Cyanide Free Immersion Gold As Sustainable Solution for High Reliability ENIG Finishes 无氰浸金是可靠性 ENIG 工艺的可持续解决方案 (CE24-TC1.5)	Kenneth Lee 李家康 Atotech 安美特
14:55 - 15:30	Engineering Curoosity and Why It Is A Must for Mission Critical Manufacturing 工程好奇心为何是关键任务制造的必要条件 (CE24-TC1.6)	Adam Klett, Ph.D Adam Klett 博士 Kyzen Corporation 美国 Kyzen 公司

All papers will be presented in Chinese 所有演讲者都将使用中文



SMTA China East 华东高科技会议 Technical Conference

25th

April 2024 (Thursday) / 2024 年 4 月 25 日(星期四)

(CE24-TC2) Technology Conference / 高科技技术研讨会

Conference Chairman/会议主席:

Yunhong Yu 余允红

Member of SMTA China Technical Advisory Committee / 中国 SMTA 技术顾问委员会委员

Global IM Electronic Market Leader of Air Liquide (China) Holding Co., Ltd.

液化空气(中国)投资有限公司全球通用市场电子市场总监

Venue/地点	Room No.6, B2, Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center 上海世博展览馆地下二层 6 号会议室	
Time/时间	Topic/主题	Speaker/演讲者
10:45 – 11:20	A Novel Lead-Free Low-Temperature Solder Paste for Wafer-Level Package Application 用于晶圆级封装的新型无铅低温锡膏 (CE24-TC2.1)	Leo Hu 胡彦杰 Indium Corporation 钢泰公司
11:20 – 11:55	The New Era of Soldering: The Evolution of Ultrafine Pastes and Precision Printing 焊接新时代: 超细焊料和精密印刷的发展 (CE24-TC2.2)	Dillon Zhu 朱军桦 AIM Solder
11:55 – 12:30	A Solution for Electronics Exposure At Harsh Environment - How to Choose The Correct Conformal Coating Through S-Corrosion Verification? 电子产品暴露于严苛环境下的解决方案 — 如何藉由硫腐蚀验证如何藉由硫腐蚀验证选择正确的敷形涂层? (CE24-TC2.3)	Dem Lee 李易展 Integrated Service Technology Inc. 宜特科技有限公司
12:30– 13:45	Lunch Break / 午餐	
13:45 – 14:20	Investigation Into Low Temperature Solder Reliability 调查低温焊锡的可靠性 (CE24-TC2.4)	Michael Osterman, Ph.D Michael Osterman 博士 University of Maryland 美国马里兰大学
14:20 - 14:55	Next-Generation High-Reliability Solder for Enabling Enhanced Thermo- Mechanical Performance In Automotive Applications 用于汽车应用的新一代高可靠性焊料, 旨在提升热机械性能 (CE24-TC2.5)	William Yu 余瑜 MacDermid Alpha Electronics Solutions 麦德美爱法

All papers will be presented in Chinese 所有演讲者都将使用中文



SMTA China East 华东高科技会议 Technical Conference

线下早鸟价格/ Early Bird: 4 月 10 日前报名/ Registered before 10 April 免费/FREE

注: 免费线下(会议室)听讲(提供研讨会主题内容简介)

Noted: Provide Conference Manual

线下正常价格 / Normal Price: 4 月 10 日后报名/ Registered after 10 April

需收取人民币 500 元/人/天, 同时报名 2 天享受 9 折优惠价格人民币 900 元/2 天

RMB500/per day, RMB900/ two days

注: 收费线下(会议室)听讲(提供商务午餐, 中国 SMTA 研讨会出席证书和电子版本论文集)

Noted: Provide Lunch Coupon, SMTA China Conference Attendance Certificate, Electroincs version of Conference Proceedings

线上早鸟价格/ Early Bird on-line: 4 月 10 日前报名/Registered before 10 April

需收取人民币 120 元/天, 同时报名 2 天享受 9 折优惠价格 216 元/2 天

RMB120/per day, RMB 216/two days

注: 收费线上(看直播)听讲(提供电子版本论文集)

Noted: Provide Electroincs version of Conferecne Proceedings

线上正常价格/ Normal Price: 4 月 10 日后报名/Registered after 10 April

需收取人民币 150 元/人/天, 同时报名 2 天享受 9 折优惠价格人民币 270 元/2 天

RMB150/per day, RMB270/two days

注: 收费线上(看直播)听讲(提供电子版本论文集)

Notd: Provide Electroincs of version Conference Proceedings

如有问题, 请咨询 SMTA 行政主任 Peggy Chen 小姐, 请致电+86-21-56093010 / 手机: +86-18202193148

或发邮件至 peggychen@smta.org.cn

Inquire: Contact Peggy Chen, SMTA China Executive Administrator, Tel: +86-21-56093010, Moblie: +86-18202193148

Or send email to peggychen@smta.org.cn

技术研讨会网上预登记二维码

Pre-Registration on-line QR Code

(CE24-TC1&TC2)



关注中国 SMTA 微信公众号二维码

Follow SMTA China WeChat QR Code

